

X-LAKE FORUM
西麗湖论坛



西麗湖論壇之粵港澳大灣區 高密度電子封裝材料與器件專業論壇

THE PROFESSIONAL FORUM FOR HIGH DENSITY ELECTRONIC PACKAGING MATERIALS AND
DEVICES IN THE GREATER BAY AREA, X-LAKE FORUM 2024

會議手冊

2024年11月22日-23日

主辦單位：高密度電子封裝材料與器件聯合實驗室

承辦單位：香港中文大學

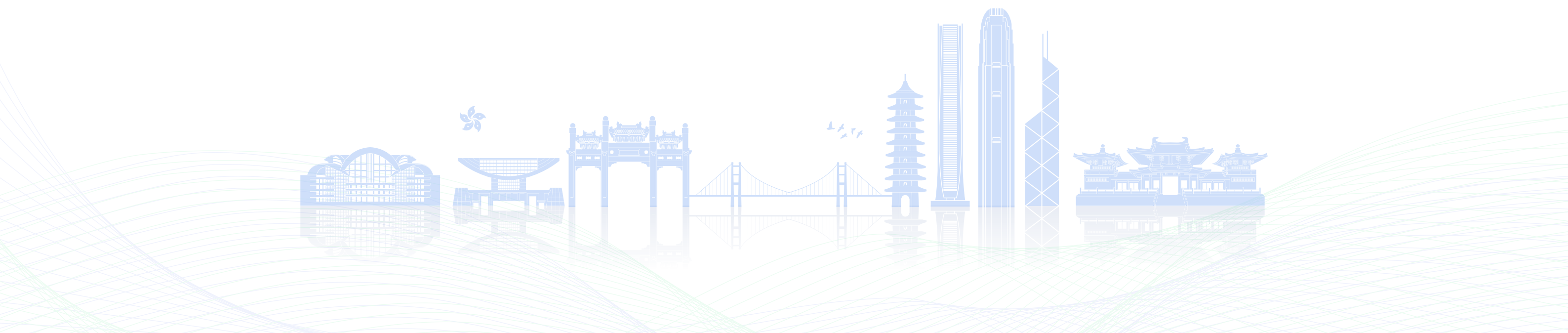
中國科學院深圳先進技術研究院

深圳先進電子材料國際創新研究院

目录

CONTENTS

01	論壇須知 ▶	01
02	報告嘉賓簡介 ▶	03
03	論壇資訊 ▶	13



論壇須知

歡迎各位嘉賓參加西麗湖論壇之粵港澳大灣區高密度電子封裝材料與器件專業論壇，論壇相關事宜及安排如下：

（一）論壇背景

在國家戰略的引領下，粵港澳大灣區正加速構建全方位互連互通新格局。2020年12月，科技部聯合教育部、廣東省人民政府共同印發專項檔，支持舉辦“西麗湖論壇”，這對於深圳市服務粵港澳大灣區國家戰略、推動粵港澳大灣區高水準人才高地建設具有重要作用。

為充分發揮粵港澳大灣區學術優勢，2013年由香港中文大學工程學院外籍院士牽頭，許建斌教授團隊與中國科學院深圳先進技術研究院先進電子材料研究中心孫蓉研究員團隊聯合共建了高密度電子封裝材料與器件聯合實驗室。聯合實驗室主要聚焦積體電路高端電子封裝材料領域的研發及其應用技術，通過滙聚深港雙方的科研優勢力量，開展大數據在材料研發中的前沿技術研究，取得了一批標誌性、引領性重大科技創新成果，並引育聯合培養多位高層次人才，致力於搭建創新發展平臺及打造人才聚集高地。

（二）論壇時間

2024年11月22日 18:30-21:30 (歡迎晚宴 - 邀請制)
2024年11月23日 09:00-16:30

（三）論壇地點

香港中文大學康本國際學術園YIA LT2 (G/F)

（四）組織機構

主辦單位：高密度電子封裝材料與器件聯合實驗室
承辦單位：香港中文大學
中國科學院深圳先進技術研究院
深圳先進電子材料國際創新研究院

（五）論壇聯繫人及聯繫方式

- 彭 斐 電話：+8618620305379
郵箱：fei.peng@siat.ac.cn
- 麼依民 電話：+8615099927852
郵箱：ym.yao@siat.ac.cn
- 梁 挺 電話：(852) 5194-9956
郵箱：tingliang@link.cuhk.edu.hk
- 王振宇 電話：(852) 5226-3151
郵箱：zy.wang4@siat.ac.cn

報告嘉賓簡介

杜經寧

中國臺灣中央研究院院士
香港城市大學講座教授



He received his PhD on applied physics from Harvard University in 1968. He spent 25 years in IBM T. J. Watson Research Center as Research Staff Member as well as Senior Manager of Materials Science Dept. in Physical Science Dept. before he joined UCLA as a full professor in 1993. He retired in 2016 from UCLA as a Distinguished Emeritus Professor. Then, he went to Taiwan and became TSMC Chair Professor as well as an E-Sun Scholar in National Yang-Ming Chiao Tung University in Hsinchu for 4 years. Now, he is a Chair Professor in Dept. of Materials Science and Engineering as well as Dept. of Electrical Engineering in City University of Hong Kong. He is a member of Academia Sinica, Taiwan. His research interest has been about metal-silicon reactions, solder joint reactions, atomic layer reactions in nanowires, microbump reactions in 3D IC, kinetic theory in nanoscale materials, electromigration, and reliability issues in advanced packaging technology.

劉漢誠

臺灣欣興電子股份有限公司CTO



John H Lau, with more than 40 years of R&D and manufacturing experience in semiconductor packaging has published more than 23 textbooks. John is an elected IEEE fellow, IMAPS Fellow, and ASME Fellow and has been actively participating in industry/academy/society meetings/conferences to contribute, learn, and share.

陳正豪

香港微電子研發院董事局主席



The Hong Kong University of Science and Technology University,
Professor Emeritus, Department of Electronic and Computer Engineering

The Hong Kong Polytechnic University, Senior Advisor to the Deputy
President and Provost

The Hong Kong Polytechnic University, Emeritus Professor, Department
of Electrical and Electronic Engineering

鄧濤

上海交通大學研究生院院長



Dr. Deng is the Dean of the Graduate School at Shanghai Jiao Tong University (SJTU) and also the Zhi Yuan Chair Professor in the School of Materials Science and Engineering at SJTU. In 1996, Dr. Deng graduated from the Department of Materials Science and Engineering at the University of Science and Technology of China with a B.S. in Materials Chemistry. From 1996-2001, Dr. Deng studied unconventional micro/nano fabrication processes and systems at the Department of Chemistry in Harvard University. After obtaining his PhD degree from Harvard University, he joined MIT as a postdoctoral fellow in the Department of Materials Science and Engineering, with research focusing on micro/nano photonics. After completing his postdoctoral training at MIT, he joined the Global Research Center of General Electric (GE) at Niskayuna, New York in 2003. He spent nine years at GE's Central Laboratory, moving up the ladder from research scientist to lead scientist and senior scientist. In the summer of 2012, he moved

back to academic research and joined the School of Materials Science and Engineering at Shanghai Jiao Tong University. His current research focuses on energy materials and systems inspired by biological systems. Dr. Deng has more than 240 publications that include publications in Science, Nature Energy, and PNAS. He also has more than 80 patents and patent applications.

Dr. Deng is a board member of the Chinese Materials Research Society (CMRS). He also served as the Conference Co-Chair for the 2017 US MRS Fall Meeting, Chair of First IUMRS Asia Advanced Materials Summit in 2021, and the Conference Co-Chair for the 2022 International Conference on Frontier Materials. He currently serves as the Associate Editor for Chemical Reviews and serves on the Editorial Board of Progress in Natural Science: Materials International.

薛泉

華南理工電子與資訊學院、
微電子學院院長



薛泉,博士, 教授, 博士生導師, IEEE Fellow, 國家海外高層次專家。

分別於1988, 1991和1993年獲電子科技大學學士、碩士和博士學位, 1993年9月留校工作。1995年破格晉升電子科技大學副教授, 1997年破格晉升電子科技大學教授。1997年10月至1998年10月在香港中文大學任副研究員、研究員。1999年加入香港城市大學, 歷任研究員、高級科學主任、副教授、教授、講座教授, 香港城市大學協理副校長, 深圳國瑞通訊有限公司總經理, 毫米波國家重點實驗室常務副主任、應用電磁學實驗室主任、資訊與通信研究中心主任。2017年8月加入華南理工大學, 擔任電子與資訊學院院長, 2018年起廣東省珠江人才團隊負責人, 2019年起擔任廣東省毫米波太赫茲重點實驗室主任, 2019年國家第六代移動通信技術研發總體專家組專家。2020年兼任華南理工大學微電子學院院長, 2011年獲選國家中組部千人計畫專家。薛泉教授還是華為2012實驗室天線首席專家。曾獲中國國家技術發明二等獎1項, 廣東省科學技術一等獎1項。2011年獲

選IEEE Fellow。2017年榮獲IEEE國際惠勒天線論文獎（IEEE Wheeler Antenna Paper Award）。先後擔任IEEE Transaction on Microwave Theory and Techniques及IEEE Transaction on Industrial Electronics IEEE Transactions on Antennas and Propagation副編輯。

在國際著名刊物上發表SCI收錄論文600餘篇，國際會議論文400餘篇。擁有100餘項中國專利和33項美國專利。論文他引次數20000餘次，H-index 為68。目前的研究方向包括微波電路與系統、射頻積體電路、天線、太赫茲技術等。成果主要應用在在新一代通信、衛星通信、無線傳感、導航等領域。

馮憲平

香港城市大學教授



馮憲平是香港城市大學先進設計與系統工程系的教授，現擔任工學院副院長（企業協作）與合作教育中心主任。他在臺灣清華大學獲得學士、碩士、博士學位。在進入學術界之前，他是臺灣積體電路公司的工程師和經理，以及健鼎科技公司的副處長。他曾在麻省理工學院擔任博士後研究員，並在香港大學擔任助理教授和副教授。他的研究重點是電化學系統設計和材料工程在綠色能源和半導體製造的應用。

他曾獲香港大學研究成果獎和知識交流獎，IChemE 全球獎的創業獎和能源獎，以及第48屆日內瓦國際發明展金獎。他是英國特許工程師（CEng）與特許科學家（CSci），材料、礦業和礦物學學會（IOM3）會士（FIMMM）和英國皇家化學學會（RSC）會士（FRSC）。透過他的專利技術，馮教授和他的團隊成立了兩家新創公司。

史訓清

香港應用科技研究院有限公司副總裁



史訓清博士現為香港應用科技研究院副總裁，帶領團隊重點開發三維小晶片、ASIC和電力儲能系統。史博士在先進半導體領域擁有超過30年的工作經驗，2007年加入應科院之前，他曾於香港城市大學、新加坡製造技術研究院、飛利浦和英特爾等機構擔任不同的研究及管理職位。史博士曾於國際學術期刊及會議發表了超過120篇論文，擁有30個專利，獲得了2020年度國家科技進步一等獎。史博士現任國家專用積體電路系統工程技術研究中心香港分中心副主任。

劉晨敏

納米及先進材料研發院CTO



劉晨敏博士是香港納米及先進材料研發院（NAMI）的首席技術官，領導NAMI的研發相關工作。她於北京航空航太大學材料科學與工程系獲得學士和材料學博士學位。在加入NAMI之前，劉博士曾在新加坡國立大學（NUS）和香港科技大學（HKUST）工作。

劉博士在納米材料的合成、表徵及其在電池、固態照明和電子設備中的應用方面擁有20多年的研發經驗。在知名期刊上發表論文20餘篇，獲得國家自然科學獎二等獎及國家教育部自然科學獎一等獎等多項獎勵。

自加入NAMI以來，劉博士已申請了30多項專利並獲授權，帶領NAMI研發團隊獲得了多項國際創新和技術成果獎項，包括愛迪生獎、全球百大研發獎（R&D 100）、CES創新獎、日內瓦國際發明展裁判嘉許金獎等。

論壇資訊

(一)23日論壇地點

香港中文大學康本國際學術園YIA LT2 (G/F)

【注】請務必攜帶身份證件入校。

(二) 22日晚宴地點

香港中文大學崇基學院教職員聯誼會會所 品御軒3A

(三) 嘉賓住宿

香港沙田凱悅酒店（毗鄰港鐵大學站）

- 酒店網址：
<https://www.hyatt.com/hyatt-regency/en-US/shahr-hyatt-regency-hong-kong-sha-tin>
- 酒店地址：香港新界沙田澤祥街18號18號
- 電話號碼：(852)3723-1234
- 入住時間：15:00
- 退房時間：11:00
- 早餐時間：06:30 am.- 10:00 am.
- 用餐地址：一樓大堂餐廳

(四) 用車安排

時間	旅遊車出發地	旅遊車到達地	事項
08:00-08:40	酒店正門	論壇地點	參加論壇
12:30-12:40	論壇地點	酒店正門	午餐
14:30-14:45	酒店正門	香港科技園	參觀交流

其他到達方式：

- ①自駕：請提前72h報備入校車輛資訊，便於備案。如因需求過多而未能安排指定停車位，請自行停泊於港鐵大學站D出口前方的公眾停車場；
- ②公共交通：港鐵大學站D出口，前行150米。
- ③如有其他用車需求，可聯繫麼依民 +8615099927852

(五) 論壇內場WIFI

Identity: Conference Guests
Login: xlake
Password: forum2024

(六) 觀眾報名

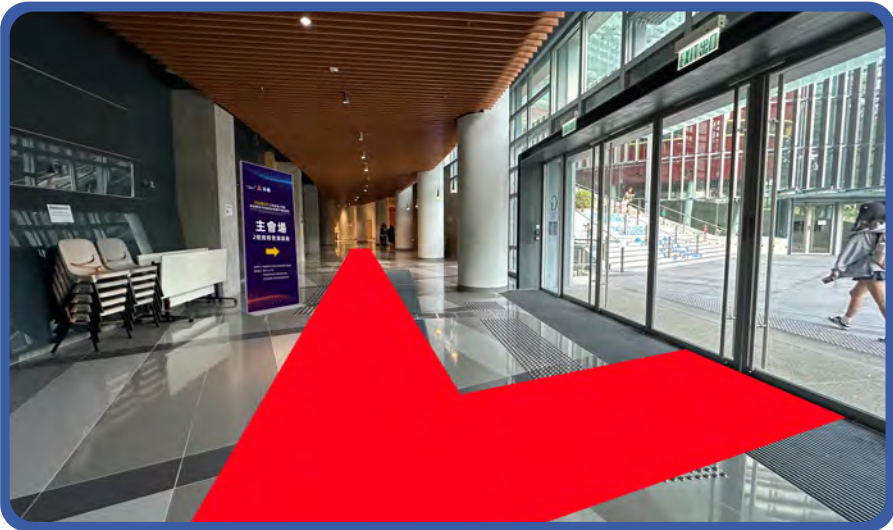
鏈接：<https://xlakeforum.erg.cuhk.edu.hk/home>

(七) 地圖指引



(八) 會場指引

(香港中文大學康本國際學術園YIA LT2 (G/F))



(九) 23日下午参访路线



科學園俯瞰圖
Science Park Location Map

- 1W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 2W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 5W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 6W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 8W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 1E** 核心大樓一座
Core Building 1
科技大道東 1 Science Park East Avenue
- 2E** 光電子中心
Photonics Centre
科技大道東 2 Science Park East Avenue
- 3E** 無線電中心
Wireless Centre
科技大道東 3 Science Park East Avenue
- 5E** 5E大樓
Building 5E
科技大道東 5 Science Park East Avenue
- 6E** 新科中心
SAE Technology Centre
科技大道東 6 Science Park East Avenue

- 9W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 10W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 11W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 12W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 15W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 16W** 核心大樓二座
Core Building 2
科技大道西 1 Science Park West Avenue
- 12E** 海濱大樓一座
Harbour View 1
科技大道東 12 Science Park East Avenue
- 16E** 海濱大樓二座
Harbour View 2
科技大道東 16 Science Park East Avenue
- 18E** 緣景樓
Green 18
科技大道東 18 Science Park East Avenue
- 20E**
科技大道東 20 Science Park East Avenue
- 22E**
科技大道東 22 Science Park East Avenue

ASTRI 2E



科技園會場 12W



科技園會場 12W(場內)



23日晚宴餐廳八方棧 16E

